广东生益科技股份有限公司

股票简称:生益科技　股票代码:600183

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	生益科技	股票代码	600183
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	温世龙
电话	0769-22271828-8225
传真	0769-22174183
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	7,933,711,753.77	6,716,303,914.77	18.13	6,746,844,701.82
归属于上市公司股东的净资产	4,414,774,665.40	4,061,378,237.98	8.70	4,088,235,374.21
经营活动产生的现金流量净额	719,354,839.01	319,497,002.56	125.15	551,532,280.61
营业收入	6,570,259,191.92	6,092,949,825.25	7.83	5,876,903,981.40
归属于上市公司股东的净利润	557,850,257.24	323,382,228.31	72.50	450,319,115.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,951,737.48	304,306,387.91	25.52	431,744,210.11
加权平均净资产收益率(%)	13.17	8.05	增加5.12个百分点	13.16
基本每股收益(元/股)	0.39	0.23	69.56	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.23	69.56	0.33

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数			93,128	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	92,248
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东莞市电子工业总公司	国有法人		229,785,410	11,255,410	无
伟华电子有限公司	境外法人		225,023,393	11,255,411	无
广东省外贸开发公司	国有法人		124,349,198		无
中国长城资产管理公司	国有法人		24,700,000		未知
国元证券股份有限公司	境内非国有法人		24,700,000		未知
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人		20,343,383		未知
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人		17,030,000		未知
济南北安投资有限公司	境内非国有法人		13,000,000		未知
中融国际信托有限公司-融鼎01号	境内非国有法人		11,700,000		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	境内非国有法人		11,509,669		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三名股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司自1998年上市以来,股权结构一直较为分散,无任何股东持股比例达到30%,没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末,公司第一大股东东莞电子持股比例为16.15%,第二大股东伟华电子持股比例为15.81%,第三大股东广东外贸持股比例为8.74%。公司的股东结构图如下:

上述股东均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形,与其他股东之间亦不存在通过协议、其他安排等方式扩大所能够支配的公司股份表决权数量的情形。因此,公司不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况。

三、利润分配预案

公司拟以2013年12月31日的公司总股本1,423,018,290股为基数,向全体股东每10股派现金红利4.00元(含税),共派现金红利569,207,316.00元,公司2013年不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需经2013年度股东大会审议通过后实施。

四、管理层讨论与分析

公司业务范围:生产和销售覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料,自有房屋出租;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。"

2013年生产各类覆铜箔板5,779.95万平方米,比上年同期增长6.06%;生产半固化片7,580.55万米,比上年同期增长10.12%。销售各类覆铜箔板5,798.57万平方米,比上年同期增长8.43%;销售半固化片7,409.06万米,比上年同期增长7.81%。生产各种规格硅微粉32,130.82吨,比上年同期增长0.97%;销售各种规格硅微粉30,372.34吨,比上年同期减少2.32%;生产销售印制电路板13.89万平方米,比上年同期减少14.52%;销售印制电路板14.82万平方米,比上年同期减少8.74%。实现营业收入657,025.92万元,比上年同期增长7.83%。

经营回顾总结及展望:

1. 经营回顾:

2013年的上半年世界经济虽然没有继续下行,但也没有明显的向好,基本上处于一种胶着和相持的阶段,世界主要经济体采取的经济或金融措施均没有在上半年产生实际的作用,但至少是阻止了经济继续走弱。而新兴经济体国家的经济结构对全球市场的依赖程度很大而受拖累,虽然这些国家均有庞大的消费人群,但因收入水平仍不高及通胀等因素,在2013年没有显示出强大的上升动力。进入2013年下半年以后,我们可以看到以美国为首,欧洲的经济均开始了复苏,日本采用的超宽松货币政策也为日本经济解冻起到了推动作用。虽然发达国家经济上升幅度非常少,但至少停止了往彻底并转而上升,为市场带来了很好的心理预期。

中国经济在2013年仍保持了7.5%以上的增长,与过去最大的不同在于,政府已放弃了干预和刺激经济的措施并坚定地进行经济结构的调整,尤其是十八届三中全会之后,开始着手进行经济体制方面的改革,彻底放弃了单纯追求GDP增长的经济政策,转而更关注民生、环境、效益、可持续发展的各个方面。改革了企业登记注册制度,减少行政审批程序和相关事项;在金融和资本市场推出的新规也日益清晰,一系列的改革都为中国经济的长期稳健发展打下了基础,而这一切都令2013年的下半年的市场开始有所反应。

电子工业产品在上述宏观经济形势的影响下,基本处于一个调整期,总体上我们在市场上看不到新技术的推出,基本仍是在原有产品上的升级换代,以手机为例,领军企业没有概念性的产品出世,但跟随性的企业则已完成了学习过程,进入一个高产期,尤其是中国手机厂家在二季度以后迅速扩大市场占有,进入更广大的消费群体,令智能手机的消费进入一个巨大增长期;汽车电子趁汽车市场产销两旺的局面整固现有技术和产品,并为下一代操控技术更加电子化准备;家电行业的空调和液晶电视一直保持了高速的增长;但笔记本电脑业除了联想之外都进入了调整期,产销比上一年又大幅下调,对市场的冲击很大;而业界对中国4G市场的投资曾寄予了厚望,但到了年尾才开始逐步见到了活跃的迹象,但对2013年于事无补;云计算、数字交换机、处理器等投资类电子产品受整体经济环境的影响,在2013年仍未见根本的起色。

2013年公司首度实施全面预算管理,各相关部门将公司的年度战略目标分解至部门的业务指标,每个月跟踪、检讨预算实施和执行状况,采取措施,全年基本可以使产能达到满产合理水平。而市场则依据预算实施高压销售,在此过程中不断捕捉市场机遇,使到2013年公司的订单一直处于满产状态,全面完成了预算目标。同时,依据预算要求,全公司大力压缩费用,严格控制成本,尤其是生产总厂依托精益生产模式的推广,将指标分解至班组全面行动,通过减少浪费,节约原、辅料,节能减耗等等措施,尤其是通过合理排产,使设备利用率大幅上升,为公司创造了可观的价值。

2013年波澜不惊地过去了,2013年似乎发生了不少的政经大事让这一年起起伏伏,但我们坚守在电子行业似乎又不受影响地按部就班地按计划和预算在走自己的路,做好自己的事情。由于判断清楚、目标明确,我们一直是采取主动态势去应对整个市场的变化,所以,还是很好地实现了各项指标,虽小有遗憾,但基本达到了预期目标。

2. 完成的几项主要工作

2-1. 推动实施完成全面预算管理

2013年是实施全面预算管理的第一年,各相关部门认真、严格、严肃地实施预算。全面预算管理推动了各部门尤其是计划、排产、销售、物流等部门工作的管理改革,在实施过程中仍存在一些问题,例如:产能最大化还有待改善,销售对预算的理解和执行也有待提高,但首年实施的成功无疑极大地坚定了我们乃至集团内各子公司推动实施全面预算管理的信心。

2-2. 实施期权

经近一年多的筹备工作,公司的期权方案于2013年8月22日第三次股东大会上审议通过,标志着公司的期权方案开始实施,这也将是公司发展历史上一个里程碑意义的事件,如能顺利实现若干期将令公司的治理结构更趋合理,也更有利于公司的长期、稳定、可持续发展。

2-3. 完成对生益电子的收购

始于2012年的与TTM商洽的对生益电子股份的收购,终于在2013年落下帷幕。以九月开始全面合并生益电子财务报表等一系列的代表性事件,标志着我们完成了一项重大的购并行动。在股东的亲自管理下,生益电子明确了新的管理和组织架构,人心趋于稳定,士气开始恢复,订单饱满并开始盈利。生益电子东城工厂的恢复建设工作有条不紊地展开,并基本按计划逐步完成各项进度,所有这一切都标志着生益电子项目已开始步入我们预定的成长轨道。

2-4. 各项投资按计划进行

在2013年我们还需继续投资完成定向募集资金的项目,在过去一年,松山湖第一工厂第六期已逐步落实,将于2014年迎接订单的增长。2013年同样以定向募集资金投资的项目二层法挠性板也已完成并已发挥了作用。计划中的陕西生益,作为股东的投资款已划拨,陕西生益的项目已于八月破土动工。

2-5. 与新日铁的合资

经充分的准备,与新日铁合资的东莞艾孚莱电子材料有限公司已于九月正式开始营业,标志着我们与世界挠性板名牌企业的联手合作已开始了一个新的阶段。经三个月的试行,已初步磨合了一些管理问题,合资公司也已将我方的2014年预算导入,并已承诺将对我们的预算负责。

2-6. 开拓台资市场

始于前二年的开拓台资市场的工作已有条不紊地展开,台湾公司已于十二月正式成立营业,开始从PCB和终端的多个角度开始渗入台资市场,逐步开始让台资主流PCB客户认识并接受我们的产品,这个工作已初见成效,至少台资客户没有以前那么抗拒我们的进入。

2-7. 技术管理新进展

在过去近十年的反复思索、实践、再思索、再实践的过程中,加上不断的积累,公司技术发展的三大平台已基本构成,一是技术研究的相关平台已基本确立,在此基础上技术积累已初见成效,推出了若干基于平台技术的产品;二是研发路线图的平台,对公司未来技术发展的方向和需要考虑功能和性能二大要素的着力点均已清晰,将会有利于指导今后的技术研究;三是成立了产品委员会,将会将技术研发的输入端和产品投放管起来,同时,也弥补了公司过去只有市场管理而没有产品管理的缺陷。

2-8. 市场开发工作逐步上轨

针对我们技术研究、产品研发以及市场推广方面的不足,五年前我们成立了市场部,但对市场部的工作以及定位一直存在众多的问题。经数年的摸索、实践、调整,尤其是培育高速、高频、导热材料的实践过程,以及汽车产品客户维护、UL维护等工作的结果验证,我们基本上可以确立以产品和客户二条主线和结合为一的市场工作模式,这对未来的技术发展和产品开发、推广具有重要意义。

三、对2014年的展望

2014年的展望,主流意见认为全球经济将会进入增长的轨道,尤其是IMF不断调整对2014年经济的预测,但均是调升,对经济增长3.7%保持了"谨慎乐观"。美国经济将会有3%的增长,就业率也将会大幅改善,失业人员下降至6%左右,同时,石油出口的增加,使其大幅减少了中东石油的进口,也就促使美国贸易逆差减少,国际收入大幅改善。日本采用超量化宽松政策之后,经济确实好转,尤其是"申奥成功"、电子工业、汽车业均向好。虽然全球经济起起伏伏,但确已由停滞转向上升,尤其是欧洲,除了德国和法国经济仍保持上升之外,英国明显复苏,爱尔兰、西班牙已摆脱欧盟的救助,其余三国的葡萄牙又明显好转,而希腊等国也已摆脱继续恶化,欧洲经济已呈现出止跌回升。中国仍将以7.5%的增长率继续稳步增长。主要经济体加上一些新的经济体,如所谓的薄荷四国--墨西哥、印尼、尼日利亚、土耳其等将会有不俗的增速,也会适当的弥补原金砖国家的下滑,总之,与2013年相比,经济总体是乐观的。

但是在一片乐观中也存在着重重矛盾和危机,首当其冲就是美国在以每次110亿的速率在退出量化宽松,将会令到一些国家的流动性下降从而引发资本性冲击,加上美国的能源工业推动其增长,而这个增长与过去完全靠消费拉动不同,增加了大家对美国经济增长实质的担心,也让已饱受人民币升值,劳动力成本上升,贸易摩擦增多的中国出口蒙上阴影。在欧洲方面,对金融危机是否真正熬过去仍有担心,金砖四国以及阿根廷等南美国家货币大跌、通胀严重也严重影响了其经济的成长,全球制造业仍处于弱势;俄罗斯投资和生产均停滞等等。当然,还需关注出现突发事件可能对经济行程的影响,例如中日之间充满外交争斗,中日之间若不能控制事态,则会发生影响中国经济进程的重大"突发事件"。所有这些又都时时在在提醒我们:市场复苏的步伐并不踏实,经济成长还随时可能出现"趟超"。

电子工业界对今年似乎已表示出了极大的热情,在去年底今年初的几个主要展览会上,汽车智能/电动化;可穿戴电子;曲屏智能手机;4D电视;i watch;谷歌眼镜等等新技术、新产品均已推出亮相,这些产品的推出集中向我们展示了一个面向消费者、面向时尚的电子消费热即将来临。而国内从去年底始,盼望已久的4G时代终于开始了,这不但会拉动设备投资,也会推动配套的终端更新换代,加上传统产业和产品的需求仍有随经济增长而不断增长的趋势,我们有理由认为,2014年电子产品市场会比2013年有一个突破性的增长。

纵观国内外经济发展趋势和电子产品的市场发展趋势,总体看向好的因素还是占主导地位,因此,我们仍有理由对2014年抱有一个期待,一个"谨慎乐观"的期待。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,570,259,191.92	6,092,949,825.25	7.83
营业成本	5,586,515,300.81	5,263,468,159.76	6.14
销售费用	159,237,905.13	131,003,004.58	21.55
管理费用	303,499,416.00	254,868,923.86	19.08
财务费用	47,200,685.52	46,671,589.66	1.13
经营活动产生的现金流量净额	719,354,839.01	319,497,002.56	125.15
投资活动产生的现金流量净额	-457,484,335.89	-187,285,401.73	-144.27
筹资活动产生的现金流量净额	278,714,047.66	-516,350,304.34	153.98
研发支出	264,568,133.83	236,762,232.51	11.74

2、成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
覆铜板和粘结片	直接材料	4,382,569,704.51	83.80	4,377,099,360.53	84.05	0.12
覆铜板和粘结片	直接人工	195,594,399.70	3.74	166,647,447.40	3.20	17.37
覆铜板和粘结片	制造费用	651,632,679.21	12.46	663,985,923.22	12.75	-1.86
印制线路板	直接材料	192,837,709.50	65.90	不适用	不适用	不适用
印制线路板	直接人工	21,613,618.89	7.39	不适用	不适用	不适用
印制线路板	制造费用	78,191,997.64	26.72	不适用	不适用	不适用
硅微粉	直接材料	31,190,735.03	66.90	28,423,307.34	69.23	9.74
硅微粉	直接人工	2,652,518.51	5.69	3,112,070.92	7.58	-14.77
硅微粉	制造费用	12,778,417.43	27.41	9,520,966.30	23.19	34.21

3、研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	264,568,133.83
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	264,568,133.83
研发支出总额占净资产比例(%)	5.82
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.03

情况说明:报告期内,公司通过市场需求分析,对于技术热点、市场趋势,适应未来发展趋势,极具发展前途的技术方向进行技术研究和新产品设计,对于正在投入使用的产品根据市场反馈情况进行改进升级,研发支出主要应用于以下几方面:

①高多层印制线路板用基材。高多层印制线路板应用于超级计算机、服务器、通讯基站等领域,代表了电子电路的先进水平和制作技术,通过对新的高性能树脂基体及其改性技术研究,开发具备高Tg、低CTE、高刚性、高耐热、高尺寸稳定性、良好的PCB加工性及可靠性等综合性能的产品,从而提高公司在该领域的市场地位。

②高频高速基材。通过研究新型树脂基体材料技术和新型增强材料及填料应用技术,开发满足信号传输的速度以及信号传输的完整性要求的产品,以满足近年来通讯业的飞速发展,对板材的介电性能提出的迫切要求。

③挠性基材。通过对无胶单面挠性覆铜板、压合型无胶双面挠性覆铜板的产业化研究,开发出了满足市场要求的无胶挠性基材,提升公司在挠性基材应用领域的竞争力。

④高导热基材。随着PCB业向着高密度、多层化方向的不断发展,小空间、高密度、大功率不可避免地产生更多的热量聚集,建立散热通道成了重要的研究课题,公司重点对高热传导性、高散热性基材的工程化技术进行了研究开发。

⑤无卤化高性能基材。通过对磷、氮、填料阻燃机理、协同作用、综合应用等技术领域的研究,掌握无卤化高性能的核心技术,以满足近年来手机、手提电脑等为代表的消费电子产品无卤化的需求。

⑥铜浆灌孔CEM-3板材研发。面对化学沉铜法、银浆灌孔法高成本的压力,PCB厂家不得不呼吁更高效、更低成本的通孔方法。日本已开发出一款铜浆灌孔的通孔工艺,并在国内几家PCB厂进行推广。这种工艺可大大降低生产成本。铜浆灌孔CEM-3板材的研发,正是为适应PCB生产的新工艺而进行的开发。

4、公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因:

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	719,354,839.01	319,497,002.56	125.15	主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围,以及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-457,484,335.89	-187,285,401.73	-144.27	主要系本期购买东莞生益电子有限公司股权而支付现金,以及处置东莞美维电路有限公司股权取得现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	278,714,047.66	-516,350,304.34	153.98	主要系本期借款收到的现金增加所致。

5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)	原因说明
营业税金及附加	39,045,321.59	22,289,831.42	75.17	主要系本期增值税免抵额增加,相应按增值税计缴的城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加增加所致
资产减值损失	4,348,746.87	8,763,835.01	-50.38	主要系公司本期全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围而增加该司数据所致
投资收益	-430,259.49	-2,558,258.92	83.18	主要系本期收购东莞生益电子有限公司股权转销以往年度股权投资差额摊销余额,处置东莞美维电路有限公司股权形成收益,以及原联营公司东莞生益电子有限公司上年同期停工改造,停工损失形成大额亏损所致
营业外收入	215,550,898.39	23,950,002.12	800.00	主要系本期折价购买东莞生益电子有限公司股权形成收益所致
营业外支出	6,969,073.74	842,389.82	727.30	主要系本期资产报废增加所致
所得税费用	79,358,810.72	49,058,441.33	61.76	主要系本期处置原联营公司东莞美维电路有限公司股权产生收益增加当期所得税费用,以及购买东莞生益电子有限公司股权后纳入合并而转销以往年度确认的股权投资差额对应递延所得税资产,相应增加所得税费用所致
属于母公司所有者的净利润	557,850,257.24	323,382,228.31	72.50	主要系本期折价购买东莞生益电子有限公司股权形成收益,以及处置东莞美维电路有限公司股权形成收益所致
少数股东损益	1,354,313.20	13,993,164.70	-90.32	主要系下属子公司苏州生益科技有限公司本期利润下降所致

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
覆铜板和粘结片	6,072,703,963.17	5,229,796,783.42	13.88	2.53	0.42	增加1.81个百分点
印制线路板	312,977,230.00	292,643,326.03	6.50	不适用	不适用	不适用
硅微粉	93,539,357.33	46,621,670.97	50.16	13.13	13.56	减少0.19个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	3,240,562,070.92	26.16
外销	3,238,658,479.58	-5.76

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,231,907,074.62	15.53	689,878,633.28	10.27	78.57
应收票据	427,423,278.67	5.39	261,814,380.59	3.90	63.25
预付款项	4,515,531.55	0.06	3,331,914.22	0.05	35.52
应收利息	577,916.66	0.01	7,400,689.66	0.11	-92.19
其他流动资产	83,734,814.12	1.06	58,920,032.57	0.88	42.12
长期股权投资	7,763,107.83	0.10	560,123,948.68	8.34	-98.61
在建工程	454,278,951.35	5.73	112,213,749.99	1.67	304.83
无形资产	234,252,718.97	2.95	154,664,319.04	2.30	51.46
短期借款	906,895,739.07	11.43	558,766,993.29	8.32	62.30
预收款项	2,161,667.85	0.03	1,108,967.82	0.02	94.93
应付职工薪酬	105,815,121.42	1.33	54,228,134.64	0.81	95.13
应交税费	43,861,130.75	0.55	27,443,724.87	0.41	59.82
应付利息	4,937,770.08	0.06	2,680,743.79	0.04	84.19
长期借款	497,937,000.00	6.28	260,835,000.00	3.88	90.90
外币报表折算差额	-1,506,485.95	不适用	-1,038,399.63	不适用	-45.08

货币资金:主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

应收票据:主要系本期以票据结算货款增加以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

预付款项:主要系按合同预付款项增加所致

应收利息:主要系公司本期募集资金定存业务进行结算而收到利息所致

其他流动资产:主要系本公司期末进口增值税海关扣款而未及时取得增值税税单导致无法及时认证抵扣所致

长期股权投资:主要系本期收购东莞生益电子有限公司股权后纳入合并范围,以及处置原联营公司东莞美维电路有限公司股权所致

在建工程:主要系本期松山湖覆铜板第六期工厂工程投入增加,以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

无形资产:主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

短期借款:主要系本期增加流动资金贷款所致

预收款项:主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

应付职工薪酬:主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

应交税费:主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

应付利息:主要系本期末随贷款增加而增加计提利息所致

长期借款:主要系本期增加流动资金贷款所致

外币报表折算差额:主要系本期汇率变动,合并全资子公司生益科技(香港)有限公司报表而折算人民币产生汇兑损失所致

(四)核心竞争力分析

①品牌优势

公司经过20多年的发展,已成为中国大陆最大的覆铜板制造商,荣获"中华之最(覆铜板生产基地)",产品被授予"中国驰名商标"。公司通过了ISO 9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO27001信息安全体系认证、TS16949质量体系认证、GBT19022计量体系认证。公司获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证,并且成为索尼绿色环保伙伴(SONY GREENPARTNER)。公司是中国电子电路行业协会(CPCA)、中国覆铜板行业协会(CCLA)的会员以及美国电子电路互连与封装协会会员(IPC MEMBER)。

②管理优势

公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定,大多数人员自参加工作即在公司,基本上与公司同步成长和发展,直接参与公司各个时期的建设和发展。经过二十年的实践锻炼,与公司已经融为一体,具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。

③技术优势

国家科技部于2012年正式批准我们组建"国家电子电路基材工程中心",针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题,持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发,为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备,不断地推出具有高增值效益的系列新产品。

(五)募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	123,755.00	14,768.11	109,770.48	13,984.52	
合计	/	123,755.00	14,768.11	109,770.48	13,984.52	/

②募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
软性光电材料产研中心项目(松山湖第一工厂第四期)	否	27,965.00	1,721.70	24,579.53	是	87.89%	977.82	否
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目(松山湖第一工厂第五期)	否	70,790.00	245.93	69,578.12	是	98.29%	9,073.02	否
LED用高导热覆铜板项目(松山湖第一工厂第六期)	否	25,000.00	12,800.48	15,612.83	否	62.45%	尚未产生效益	不适用
合计	/	123,755.00	14,768.11	109,770.48	/	/	/	/
未达到收益说明	1、高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目未达到预计收益主要原因系:项目预测时,处于3G投资高峰期,高性能刚性覆铜板和粘结片的价格属于高位,预测的收益较高。而近两年受全球经济调整影响,中国经济也逐渐进入中速发展时期,导致电子通讯基础设备投资速度放缓及行业产能扩张过快等多方面因素的影响,行业竞争激烈,产品价格下降等多种因素叠加,导致该项目未能达到预期收益。 2、软性光电材料产研中心项目未达到预计收益主要原因系:挠性覆铜板产品主要应用于手机等消费类电子产品,终端产品价格下降非常大,同时中国近年有十多家企业新投资业生产挠性覆铜板及覆盖膜,造成行业产能严重过剩,产成品价格下降50%以上,直接对项目的经济效益造成严重影响,使项目到目前为止未达满产满销。生益科技在想尽办法调整产品结构,集中力量生产效益好的品种以提高项目的经济效益,同时也在积极与新日铁合作,以期加快开发在高端市场上的应用,寻找避免红海竞争。							

(六)公司股权激励情况及其影响

公司于2013年5月7日和2013年8月22日分别召开第七届董事会第十三次会议和2013年第三次临时股东大会,审议通过了《"广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划"》。并于2013年8月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

根据公司股票期权激励计划,公司将授予激励对象4,980.56万份股票期权,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买1股生益科技股票的权利,标的股票总数占公司股本总数142,301.83万股的3.50%。该次股票期权授予概况如下:

①)股票来源:公司向激励对象定向发行股票。

②)股票期权授予日:2013年8月26日。

③)本期股票期权授予对象及授予数量:授予295名激励对象4,980.56万份股票期权,激励对象系公司董事、高级管理人员、中层管理人员或核心骨干员工。

④)行权价格:授予股票期权的行权价格为:4.41元。

⑤)主要行权条件:在本股票期权激励计划有效期内,以2012年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数,2013-2015年相对于2012年的净利润增长率分别不低于15%、32%、52%;相比2012年度,2013-2015年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于9.5%、10%、10.5%。

⑥)行权安排:在满足行权条件的情况下,激励对象获授的股票期权分为3批行权。具体行权时间安排如下表所示:

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例
第1个行权期	自授权日起12个月后的第1个交易日起至授权日起36个月内的最后1个交易日当日止	20%
第2个行权期	自授权日起24个月后的第1个交易日起至授权日起48个月内的最后1个交易日当日止	40%
第3个行权期	自授权日起36个月后的第1个交易日起至授权日起60个月内的最后1个交易日当日止	40%

⑦)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择了布莱克-斯克尔斯期权定价模型(Black-Scholes Model)对公司授予的4,980.56万份股票期权的公允价值进行测算。根据股票期权授予日(2013年8月26日)公司股票收盘价为5.05元,采用Black-Scholes期权定价模型计算出公司授予的4,980.56万份股票期权总价值为8,286.62万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件且在各行权期内全部行权,根据《企业会计准则第11号—股份支付》,该股票期权成本将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销,则理论上2013年-2016年股权成本摊销情况将会如下表所示:

单位:万元

期权费用	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
第一批	434.46	868.93	-	-	1,303.39
第二批	512.35	1,537.04	1,024.69	-	3,074.08
第三批	434.35	1,303.05	1,303.05	868.70	3,909.15
合计	1,381.16	3,709.02	2,327.74	868.70	8,286.62

由于2013年度扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率达不到9.5%的行权条件之一,因此不确认该批期权成本。公司2013年度摊销的股票期权成本为946.70万元,其中属于第二批期权成本512.35万元,第三批期权成本434.35万元。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司目前主业为从事覆铜板制造与销售业务,此类业务2013年销售收入占到公司总收入的92.43%。按照PRISMARK的行业调查统计,目前公司覆铜板业务销售规模位居世界第三,也是全球覆铜板行业中品种规格最为齐全的公司之一。

覆铜板行业经过数十年的市场化竞争,目前全球已经形成了相对集中和稳定的供应格局,全球前三家市场份额约为32.2%,前十家市场份额约为72.2%。

(二)公司发展战略

覆铜板业务是一个高度市场化全球化竞争的成熟行业,公司能够在这个行业中取得目前的行业地位来之不易,这种行业地位既是公司竞争力的表现和结果,也将对公司未来经营提供扎实的基础。

覆铜板产品尚未出现替代产品,电子行业的发展还在对覆铜板行业提出更大量的需求和更多性能需求,这就给了覆铜板行业一个可以继续做大做强的发展空间。

公司是我们国家覆铜板行业最具完整技术研究开发能力的企业,国家工程中心落户在公司必将进一步提升公司的研发水平。

由于公司一直坚持专业化方向,目前公司是全球最大的各类覆铜板原物料采购商,与全球主要原材料供应商结成了战略发展伙伴关系。

公司目前客户群以中资、港资以及欧美资本的PCB为主,正在扩大在台资、韩资、日资等PCB客户中的市场占有率。

因此,公司未来战略仍将坚持做大做强覆铜板主业为主,继续强化公司在多品种、交货、质量、价格、技术等综合竞争优势,针对不同竞争对手,通过差异化竞争赢得竞争优势。

为了配合做大做强主业,公司将进一步通过资产整合,优化资产结构,促使非主营业务资产发挥更大经济效益。

在继续做大做强覆铜板主业的同时,公司将积极研究关注与主业技术或业务相关的产业项目,以及新兴产业、高新技术项目的投资机会,以保证公司可持续的长远发展。

(三)经营计划

2014年广东生益科技、苏州生益、陕西生益三家公司计划共经营硬性覆铜板5867万平方米,比2013年增9.3%,粘结片7998万米,比2013年增13.3%。挠性板451万平方米,比2013年增55.5%,

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续优化资产结构,合理统筹各项资金的使用,加强运营资金管理,提高运营资金的周转速度,同时通过全面预算管理的实施,严格控制各项生产经营成本。公司为维持日常经营和项目投资的资金需求主要通过自有资金、银行借款、贸易融资等方式予以满足,根据测算,2014年公司因维持日常业务并完成在建投资项目的资金需求约为35亿元。

(五)可能面对的风险

①宏观经济及政策风险

从国际看,金融危机的影响呈现长期化趋势,世界经济低速增长态势仍将延续,形势错综复杂、充满变数;从国内看,我国经济保增长、调结构,实现经济转型的压力较大。公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,与宏观经济呈正相关,当前,国家正在大力推进经济体制改革,转变经济发展方